



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20121015001  
2012 年 10 月 31 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HPA/PWR DGK/DGS パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイヤ変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -		
変更内容	HPA/PWR DGK/DGS パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイヤ変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013年2月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し		<input type="checkbox"/> 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) DGK/DGSパッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイヤを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに替えて、Cu(銅)線ボンディングワイヤに変更します。組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイヤ	Au(金)線	Cu(銅)線
ワイヤ径	1 mil	1 mil

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
DAC8801IDGKR	HPA00165DGSR	OPA2244EA/2K5	OPA2376AIDGKT	TPS2490DGS
DAC8801IDGKRG4	HPA00218AIDGKR	OPA2244EA/2K5G4	OPA2376AIDGKTG4	TPS2490DGS4
DAC8801IDGKT	HPA00590DGSR	OPA2320AIDGKR	OPA2377AIDGKR	TPS2490DGSR
DAC8801IDGKTG4	HPA00778EA/2K5	OPA2320AIDGKT	OPA2377AIDGKT	TPS2490DGSRG4
DAC8811IBDGKR	OPA2188AIDGKR	OPA2322AIDGKR	OPA727AIDGKR	XTR117AIDGKR
DAC8811IBDGKRG4	OPA2188AIDGKT	OPA2322AIDGKT	OPA727AIDGKRG4	XTR117AIDGKRG4
DAC8811IBDGKT	OPA2237EA/250	OPA2369AIDGKR	OPA727AIDGKT	XTR117AIDGKT
DAC8811IBDGKTG4	OPA2237EA/250G4	OPA2369AIDGKRG4	OPA727AIDGKTG4	XTR117AIDGKTG4
DAC8811ICDGKR	OPA2237EA/2K5	OPA2369AIDGKT	PGA112AIDGSR	
DAC8811ICDGKRG4	OPA2237EA/2K5G4	OPA2369AIDGKTG4	PGA112AIDGSRG4	
DAC8811ICDGKT	OPA2244EA/250	OPA2376AIDGKR	PGA112AIDGST	
DAC8811ICDGKTG4	OPA2244EA/250G4	OPA2376AIDGKRG4	PGA112AIDGSTG4	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年9月26日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2		
Qual Device:	INA170EA/A	INA203AIDGSR		
Assembly Site:	ASESH	ASESH		
Package/Code/Pins:	VSSOP/DGK/8	VSSOP/DGS/10		
Mount Compound:	EY1000063	EY1000063		
Mold Compound:	EN2000515	EN2000515		
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	1.0 Mil Dia., Cu		
Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	NiPdAuAg, Cu		
MSL:	JEDEC L-2/260C	JEDEC L-2/260C		
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Device1	Device2	
High Temp Operating Life	150C, 1000 hrs	77/0	-	
High Temp Operating Life	150C, 327 hrs	-	73/0	
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	
**Temperature Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	
X-ray	top side only	5/0	5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年9月26日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2		
Qual Device:	TMP431ADGKR	TMP75AIDGKR		
Assembly Site:	ASESH	ASESH		
Package/Code/Pins:	VSSOP/DGK/8	VSSOP/DGK/8		
Mount Compound:	EY1000063	EY1000063		
Mold Compound:	EN2000515	EN2000515		
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	1.0 Mil Dia., Cu		
Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	NiPdAuAg, Cu		
MSL:	JEDEC L-2/260C	JEDEC L-2/260C		
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Device1	Device2	
High Temp Operating Life	150C, 300 hrs	77/0	77/0	
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	
**Temperature Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	
X-ray	top side only	5/0	5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				